

2018-2024年中国LED用衬底材料市场评估分析及 发展前景调研战略研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2018-2024年中国LED用衬底材料市场评估分析及发展前景调研战略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/355808.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

报告目录：	第一章2015-2017年半导体照明（LED）产业总体分析
1.12015-2017年全球LED产业总体发展	1.1.1产业发展现状 1.1.2重点区域市场
1.1.3企业竞争格局	1.1.4专利技术现状 1.1.5照明市场前景
1.22015-2017年中国LED产业发展现状	1.2.1行业发展现状 1.2.2市场发展特点
1.2.3产量规模分析	1.2.4技术前沿热点 1.2.5技术发展趋势
1.32015-2017年中国LED市场发展现状	1.3.1主要应用需求 1.3.2出口情况分析
1.3.3产业集群现状 1.3.4企业购并整合	1.42015-2017年中国LED产业链发展分析
1.4.1产业链组成环节 1.4.2产业链发展透析 1.4.3产业链主要壁垒 1.4.4产业链发展趋势	
第二章2015-2017年LED用衬底材料发展综述	2.1LED衬底材料的基本情况
2.1.1LED外延片基本概述	2.1.2红黄光LED衬底 2.1.3蓝绿光LED衬底
2.2LED用衬底材料总体发展状况	2.2.1全球LED材料市场 2.2.2中国市场发展现状
2.2.3技术发展现状分析 2.2.4衬底材料发展趋势	第三章2015-2017年蓝宝石衬底发展分析
3.1蓝宝石衬底的基本情况	3.1.1蓝宝石衬底材料的特征 3.1.2外延片蓝宝石衬底要求
3.1.3蓝宝石生产设备的情况	3.1.4蓝宝石晶体生产方法 3.2蓝宝石衬底材料市场分析
3.2.1全球市场现状 3.2.2中国市场现状 3.2.3中国市场格局 3.2.4技术发展分析	
3.2.5发展困境分析 3.3蓝宝石项目生产状况 3.3.1原材料 3.3.2生产设备 3.3.3项目进展	
3.4市场对蓝宝石衬底的需求分析 3.4.1民用半导体照明 3.4.2民用航空领域 3.4.3军工领域	
3.4.4其他领域 3.5蓝宝石衬底材料的发展前景 3.5.1全球发展趋势 3.5.2未来市场需求	
第四章2015-2017年硅衬底发展分析	4.1半导体硅材料的基本情况 4.1.1电性能特点
4.1.2材料制备工艺	4.1.3材料加工过程 4.1.4主要性能参数
4.2硅衬底LED芯片主要制造工艺的综述	4.2.1Si衬底LED芯片的制造
4.2.2Si衬底LED封装的技术	4.2.3S衬底LED芯片的测试结果
4.3硅衬底上GaN基LED的研究进展	4.3.1优缺点分析 4.3.2缓冲层技术 4.3.3LED器件
4.4硅衬底材料技术发展	4.4.1国内技术现状 4.4.2中外技术差异
第五章2015-2017年碳化硅衬底发展分析	5.1碳化硅衬底的基本情况 5.1.1性能及用途
5.1.2基础物理特征	5.2SiC半导体材料研究的阐述 5.2.1SiC半导体材料的结构
5.2.2SiC半导体材料的性能	5.2.3SiC半导体材料的制备 5.2.4SiC半导体材料的应用
5.3SiC单晶片CMP超精密加工的技术分析	5.3.1CMP超精密加工发展 5.3.2CMP技术的原理
5.3.3CMP磨削材料去除速率	5.3.4CMP磨削表面质量 5.3.5CMP影响因素分析
5.3.6CMP抛光的不足	5.3.7CMP的发展趋势 5.4碳化硅衬底材料发展现状
5.4.1技术发展状况 5.4.2市场发展状况	第六章2015-2017年砷化镓衬底发展分析
6.1砷化镓的基本情况	6.1.1定义及属性 6.1.2材料分类 6.2砷化镓在光电子领域的应用
6.2.1LED需求市场 6.2.2LED应用状况	6.3砷化镓衬底材料的发展 6.3.1国外技术发展

6.3.2国内技术发展	6.3.3国内生产厂家	6.3.4材料发展趋势	6.3.5市场规模预测
第七章2015-2017年其他衬底材料发展分析	7.1氧化锌	7.1.1氧化锌的定义	
7.1.2物理及化学性质	7.2氮化镓	7.2.1氮化镓的定义	7.2.2GaN材料特性
7.2.3GaN材料应用	7.2.4技术研究进展	7.2.5未来发展前景	
第八章2015-2017年LED用衬底材料行业重点企业分析	8.1国外主要企业		
8.1.1京瓷 (Kyocera)	8.1.2Namiki	8.1.3Rubicon	8.1.4Monocrystal
8.1.5CREE			
8.2中国台湾主要企业	8.2.1台湾中美硅晶制品股份有限公司		
8.2.2台湾合晶科技股份有限公司	8.2.3台湾鑫晶钻科技股份有限公司		
8.2.4台湾晶美应用材料股份有限公司	8.2.5台湾锐捷科技股份有限公司		
8.3中国大陆主要企业	8.3.1天通控股股份有限公司	8.3.2浙江水晶光电科技股份有限公司	
8.3.3贵州皓天光电科技有限公司	8.3.4哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司		
8.3.5云南省玉溪市蓝晶科技股份有限公司	8.3.6青岛嘉星晶电科技股份有限公司		
8.3.7深圳市爱彼斯通半导体材料有限公司			
第九章2018-2024年LED用衬底材料行业投资分析	9.1LED照明行业投资时期		
9.2中国LED市场发展前景	9.3全球市场发展规模预测	9.4LED行业上游投资风险分析	
图表目录：	图表12012-2017年全国发光二极管 (LED) 行业产量及同比		
图表22017年全国发光二极管 (LED) 行业累计产量主要地区同比增长情况			
图表32017年全国电光源行业月度产量及同比			
图表42017年全国电光源累计产量地区占比情况	图表52009-2017年全球LED照明市场规模		
图表6LED应用领域细分情况	图表72010-2017年中国LED显示屏应用产值		
图表82010-2017年中国LED背光源应用产值			
图表92010-2017年中国LED照明产品市场渗透率	图表102018年全球LED材料市场规模		
图表11使用蓝宝石衬底做成的LED芯片示例	图表12蓝宝石生产线设备明细		
图表13三种衬底性能比较	图表14晶格结构示意图	图表15晶向示意图	
图表16Si衬底GaN基础结构图	图表17封装结构图	图表18SiC其它的优良特性	
图表19SiC单晶片CMP示意图	图表202015年碳化硅全年出口数量及变化情况		
图表212006-2015年中国碳化硅出口数量、价格变动情况			
图表222015年中国碳化硅主要出口国及其数量			
图表232015年中国碳化硅出口主要国家 (地区)	图表24砷化镓基本属性		
图表25GaAs晶体生长的各种方法的分类	图表26LED发光亮度		
图表27我国砷化镓在高亮度LED应用市场构成	图表28中国砷化镓材料主要生产企业		
图表29京瓷公司各业务部门的销售额构成比例 (合并)			
图表30京瓷公司各地区的销售额 (合并) (截至2016年3月底的会计年度)			
图表31京瓷公司销售额变化 (并表)			
图表32京瓷公司本年度税前利润、净利润的变化 (并表)			

图表332014-2017年台湾中美硅晶制品营业收入

图表34哈尔滨工大奥瑞德光电技术有限公司主营业务分行业、分产品、分地区情况

图表35哈尔滨工大奥瑞德光电技术有限公司产销量情况分析表

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/355808.html>